

拡販技術サポート 1 :

東芝ディスクリート製品、LSI製品に関するお客さまへの技術サポート、技術情報(最新技術動向、新製品紹介、ソリューション提案など)提供、市場技術動向調査などを行います。

◆技術サポート、技術情報提供

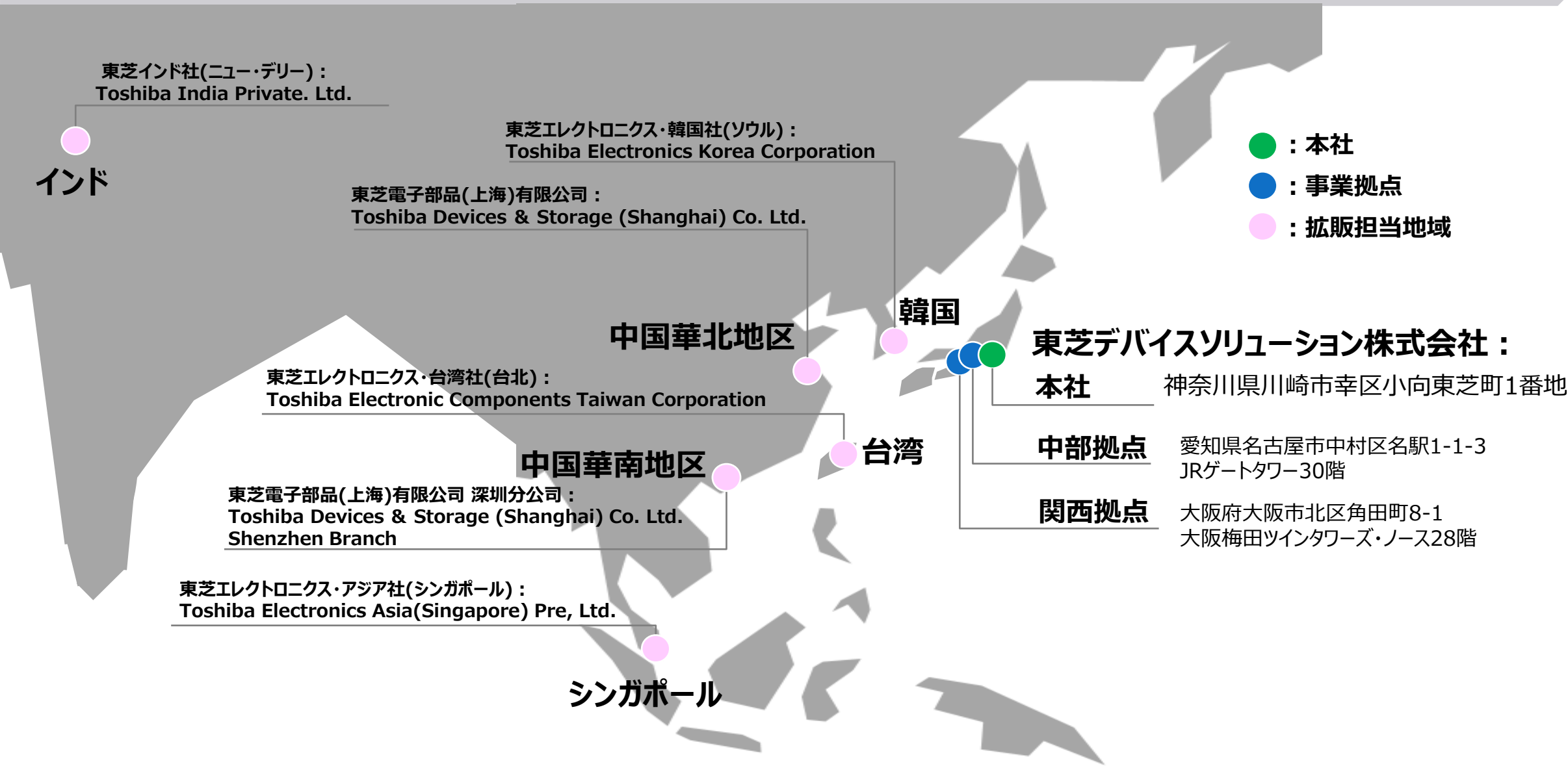
- ・技術サポートを主体として、新製品および製品開発動向の紹介、ソリューション提案等からお客さまのシステム開発支援。
- ・リファレンスツールやアプリケーションノート等、周辺技術を含めた技術情報の提供。
- ・シミュレーション(熱シミュレーション、回路シミュレーション)の解析および、それに伴う半導体製品の3Dモデル、SPICEモデルのサポート。

◆市場技術動向調査

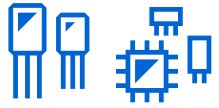
- ・各種システムの市場動向を把握し、次世代製品の商品企画を行います。

拡販技術サポート2：お客さまサポート

2026年10月1日時点



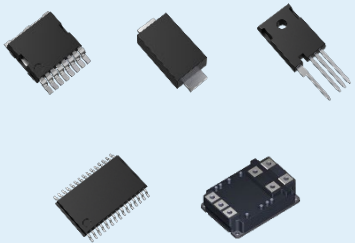
拡販技術サポート3：取り扱い製品/主要アプリケーション



ディスクリート半導体

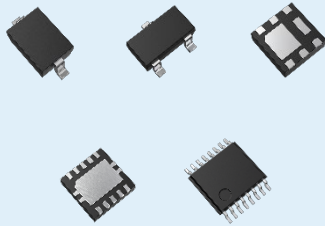
パワー半導体

MOSFET、IGBT、ダイオード、
パワーIC、SiC



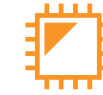
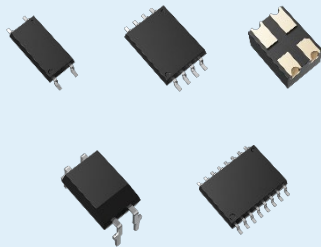
小信号半導体

ダイオード、トランジスター、
アナログIC、ロジックIC



アイソレーション半導体

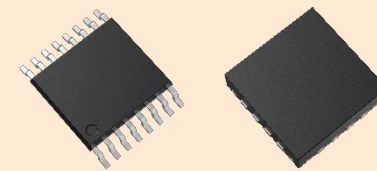
フォトカプラー、フォトリレー、
デジタルアイソレーター



システム半導体

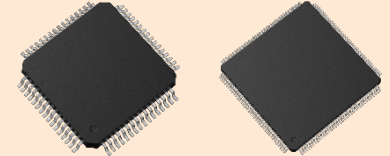
ドライバーIC

モータードライバー、
LEDドライバー

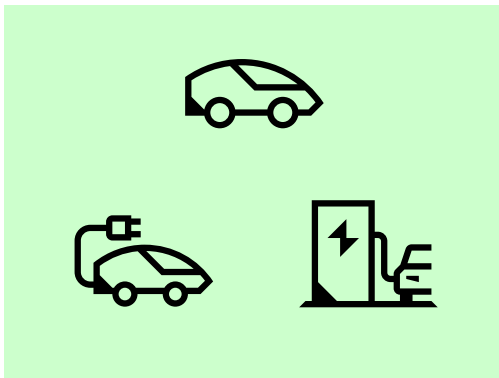


マイクロコントローラー

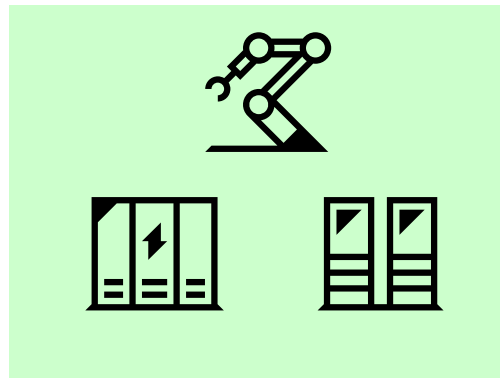
Arm® Cortex®-
Mcore シリーズ



車載機器



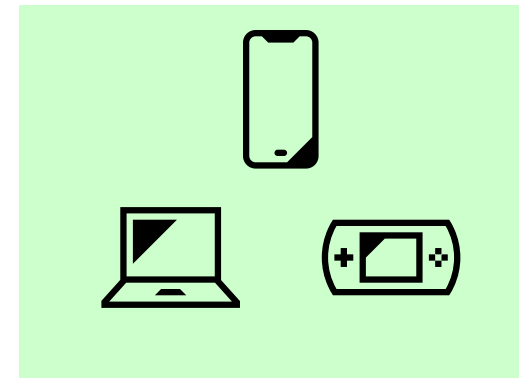
産業機器



家電・民生機器

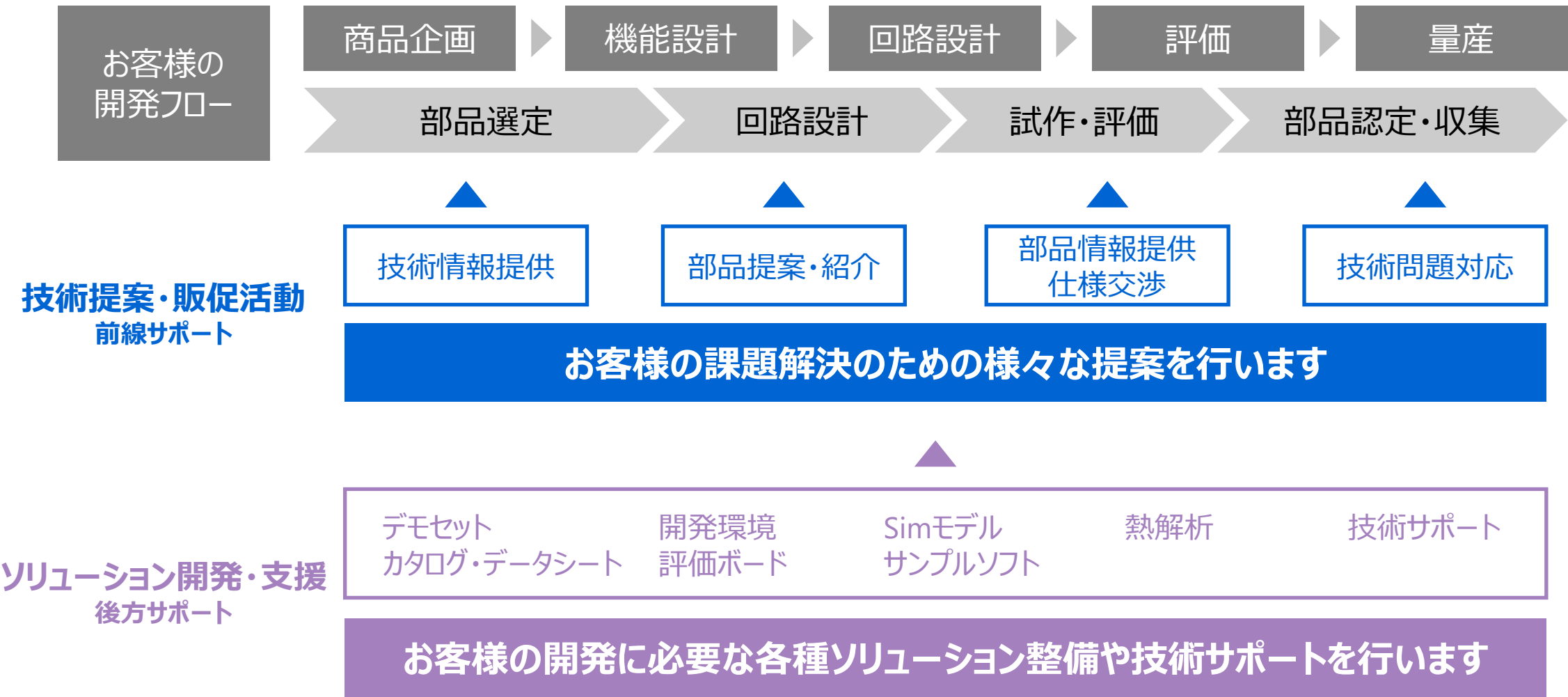


デジタル機器



拡販技術サポート4：拡販技術活動のフロー

お客様の商品開発の流れの中で技術支援を行います



拡販技術サポート5：技術提案・販促活動の概要

お客様への技術支援やマーケティング活動により東芝半導体製品の販売拡大に貢献します

製品提案・課題解決

半導体製品知識やアプリケーション知識をベースに、

- お客様のご要望に沿った製品提案を行います
- シミュレーション等のツールを活用しながらお客様の課題解決をサポートします



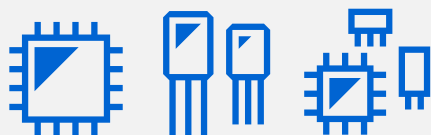
マーケティング戦略立案・実行

お客様から得られる情報、セグメント調査情報、各種メディアの情報を活用し、半導体分野の市場動向を把握し、マーケティング戦略を立案し実行します



新製品企画

お客様への技術サポートから得られる情報、市場動向、競合他社の情報等を基に、次世代製品の企画を行います



営業支援

- 東芝半導体製品のラインアップ、特長等の情報を提供します
- ターゲットとなる市場の動向、使用が予想される半導体製品、競合他社の情報等を提供します



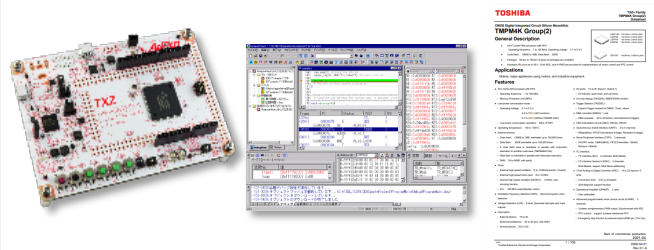
拡販技術サポート6：ソリューション開発・支援活動の概要

お客様への技術支援に必要な各種ツールの企画・開発を行います

ソリューション整備

お客様が東芝製マイコンを使用するために必要不可欠なツールの開発・整備を行います

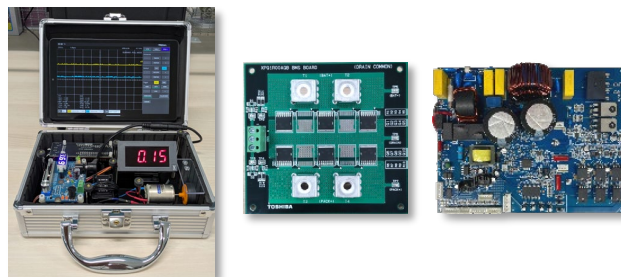
- サンプルソフトウェア
- 統合開発環境(コンパイラ、デバッガ、シミュレーター、OS)
- スターターキット、評価ボード
- データシート、マニュアル



拡販支援ツール整備

お客様の課題解決や東芝半導体製品のメリットを理解いただくツールの企画・作成を行います

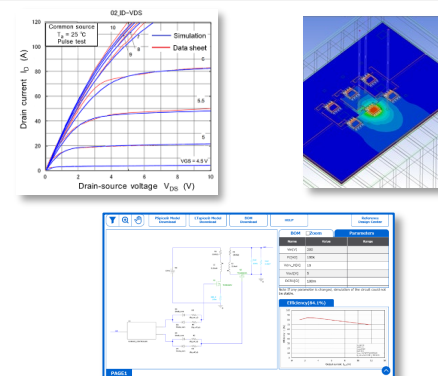
- デモセット・ボード
- 評価ボード
- リファレンスモデル



シミュレーションサポート

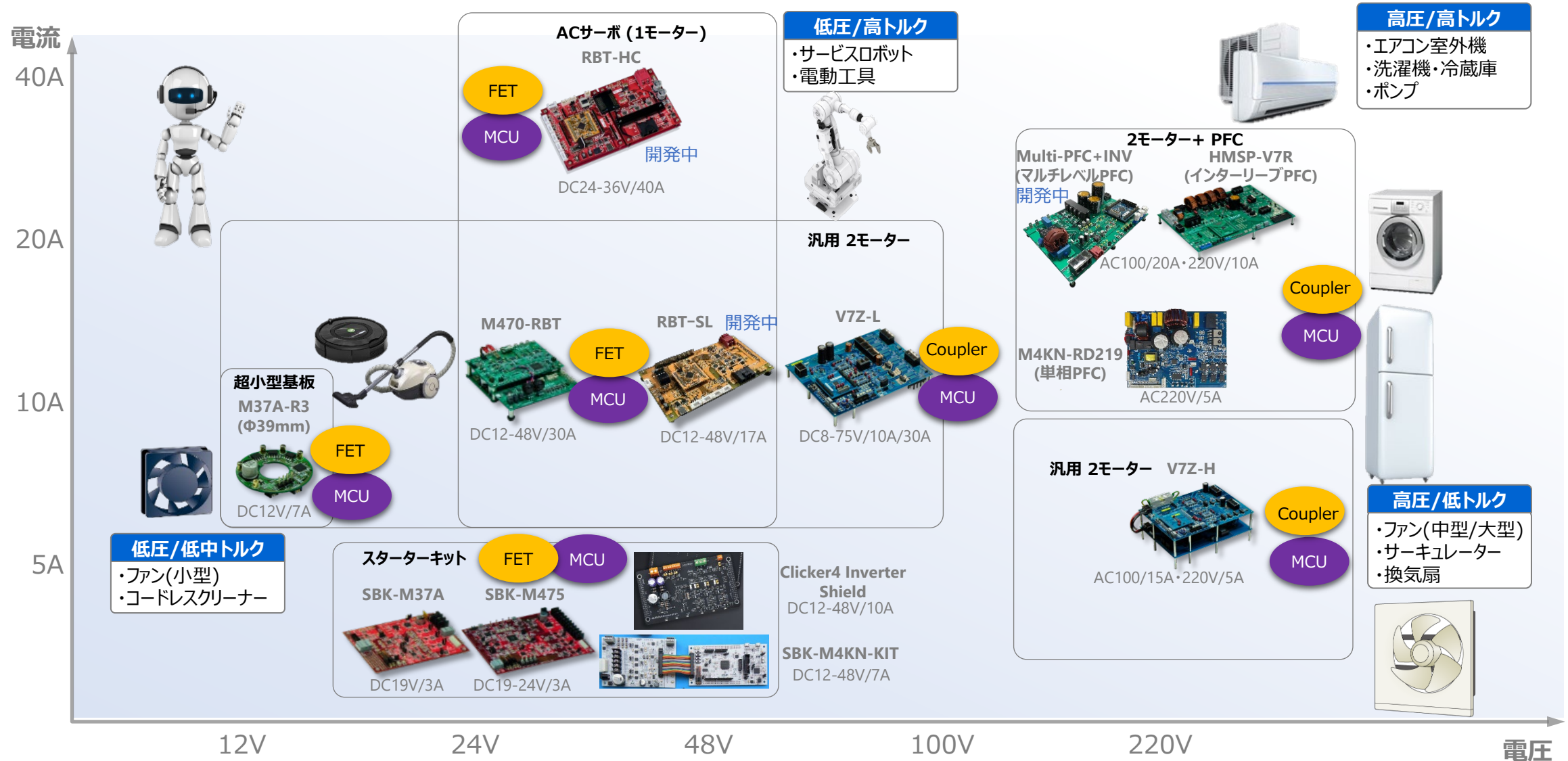
お客様の開発・設計で必要となる東芝半導体製品のシミュレーションモデルの作成や、回路・熱シミュレーションによるサポートを行います

- SPICEモデル
- 熱モデル
- 回路・熱シミュレーション



拡販技術サポート7：システムソリューション提案

「ディスクリート製品」と「LSI製品」コラボによるデバイスソリューションを提供



最先端のシステムソリューションを
「ディスクリート製品」と「LSI製品」の最適な組み合わせにより開発します。

TOSHIBA